

**耐落下衝撃**

**アンダーフィル補強**

**サイドフィル補強**

**用途**  
**半導体パッケージ/モバイル**  
 LSI パッケージ、SSD(ノートPC、デジカメ、携帯電話、スマートフォン、タブレットPC用)

## CV5313 CV5314

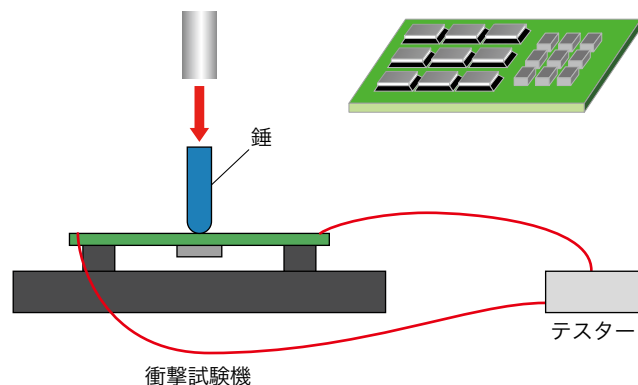
### 二次実装補強用 耐落下衝撃性液状封止材

モバイル端末の「ブレイン」を落下衝撃から守ります。  
 BGA、CSP 実装時のアンダーフィル・サイドフィル補強材料

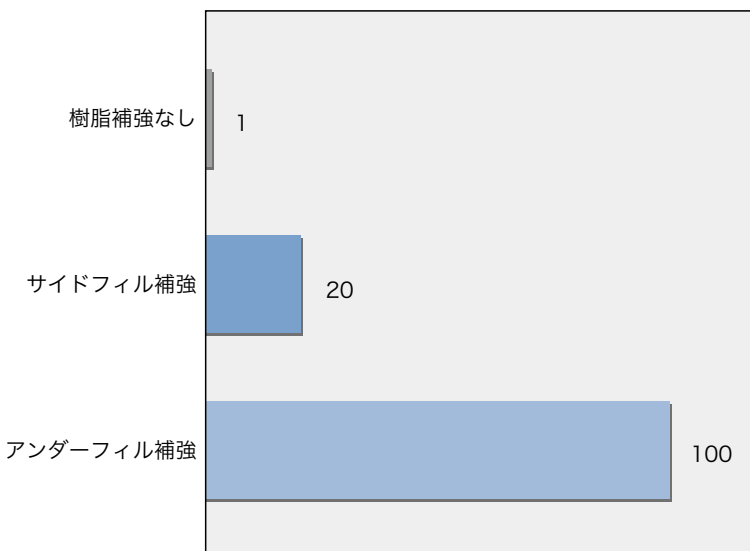
#### 衝撃試験評価比較

##### 試験条件

歪み量	3000 $\mu$ ST (Weight 50g 30cm drop)
BGA	W14mmxD14mmxH1.2mm
基板	W35mmxD70mmxH0.6mm



##### クラック発生までの落下回数



#### 一般特性

項目	単位	LEXCM <sup>DF</sup> CV5313 (Underfill)	LEXCM <sup>DF</sup> CV5314 (Underfill)
粘度 (25°C)	Pa·s	2	130
チクソ指数	—	1.2	3.5
ゲル化タイム (150°C)	秒	50	70
推奨キュア条件	—	120°C 5分	120°C 5分
ガラス転移温度 (Tg)	°C	105	80
熱膨張係数 ( $\alpha$ 1)	ppm/°C	70	35
曲げ弾性率	GPa	3	7

商品のご採用にあたっては、当社webサイトより注意事項をご確認ください。

上記データは当社測定による代表値であり、保証値ではありません。

[industrial.panasonic.com/jp/electronic-materials](http://industrial.panasonic.com/jp/electronic-materials)

パナソニック インダストリー株式会社 電子材料事業部

Panasonic Industry CV5313

© Panasonic Industry Co., Ltd. 202307